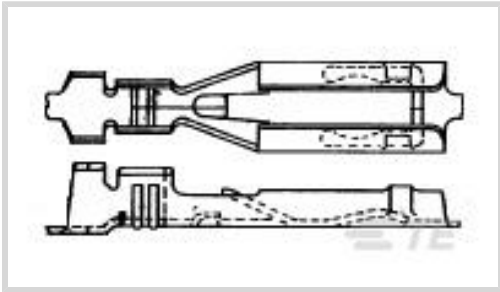




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

导线端子端接区域电镀材料: **金**

工作电压: 30 VDC

产品特性

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------

接触件特性

端子方向	直角
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀厚度	.76 µm[30 µin]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	金
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

载带安装方向	末端馈线
带导线绝缘	带有
壳体內的端子定位器类型	锁定枪



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.02 – 2.03 mm[.04 – .08 in]
线径	.2 – .6 mm²

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	10000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-178313-2
DYNAMIC D3100 HDR V 3P ASSY

TE 产品编号1-177648-5
D3100S DYNAMIC W-T-W TAB HSG

TE 产品编号CAT-D9934-A75
Dynamic 3000 端子

TE 产品编号1-1717834-3
DYNAMIC 2000 REC HSG 6P X KEY WITH CUTTI

TE 产品编号1-178129-6
DYNAMIC 3200 REC HSG 6P (DBL)

TE 产品编号172042-1
MIC CAP 9P

TE 产品编号172039-1
MIC 7P CAP ASSY

文档

AMP BLADE RECP PLTD 30 AU

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66005-2_CJ.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66005-2_CJ.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66005-2_CJ.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。